

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解貴金属メッキ方法と工程

	[収録年度]	[収録点数]	[CD-ROM版・B5製本版]	[一括購入]
セットA [公開編]	平成18年(1年間)	66点	¥24,255-	¥35,700- (全て税込価格)
セットB [公開編]	平成19年(1年間)	66点	¥24,255-	¥35,700-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	点	本体価格
No,9997(C)	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.17 84点	¥18,600
No,9997(B)	"	"	平.16 65点	¥19,200
No,9997(A)	"	"	平.15 62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-14 84点	¥16,800
No,9060	"	"	平.11-12 65点	¥24,200
No,8593	"	"	平.9-10 62点	¥23,700
No,8083	"	"	平.7-8 66点	¥29,500
No,7795	"	"	平.5-6 63点	¥24,700
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9 65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-19 62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17 100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-12 68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12 71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-12 70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12 71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11 81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11 75点	¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11 103点	¥35,000
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-12 68点	¥24,700
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12 60点	¥23,200
No,9192	"	抗菌性メッキ加工方法と製品	平.9-12 57点	¥22,800
No,9214	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.10-12 59点	¥20,900
No,9240	"	電解メッキ用給電装置の構造	平.5-12 103点	¥30,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. _____ CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名 _____
	合計 ¥ _____
担当者名	E-mail _____
	() Fax ()
住所 〒 _____	

無電解貴金属メッキ方法と工程(セットA・B)

No.10201

セットA[公開編] 平成18年(1年間) 66点 CD-ROM版 ¥24,255 B5製本版 ¥24,255 一括購入 ¥35,700 (全て税込価格)

セットB[公開編] 平成19年(1年間) 66点 CD-ROM版 ¥24,255 B5製本版 ¥24,255 一括購入 ¥35,700 (全て税込価格)

(セットA)

- 1 置換析出型金めっきの前処理用活性化組成物 奥野製薬工業株式会社
- 2 アラミド繊維材料の無電解銀めっき 名古屋メッキ工業株式会社
- 3 無電解めっきの前処理方法及び無電解めっき方法 日立化成工業株式会社
- 4 耐食材及びその製造方法 株式会社フルヤ金属
- 5 2液性無電解銀めっき液 奥野製薬工業株式会社
- 6 銀担持触媒及びその製造方法並びに銀触媒担持型ガス拡散電極及びそれを用いた電解酸化処理... 富士写真フイルム株式会社
- 7 セラミックス基材表面への金属皮膜形成方法及び金属化処理セラミックス基材 三ツ星ベルト株式会社
- 8 半導体装置の製造方法 東京エレクトロン株式会社
- 9 無電解金属めっきの前処理方法 独立行政法人科学技術振興機構
- 10 無電解金めっき液の安定化方法 株式会社日鉱マテリアルズ
- 11 光触媒を用いるプリント基板の無電解鍍金方法 三星電機株式会社
- 12 銀鏡用活性化処理液および銀鏡皮膜の形成方法 三菱製紙株式会社
- 13 銀鏡用活性化処理液および銀鏡皮膜の形成方法 三菱製紙株式会社
- 14 フッ素系高分子材料表面への金皮膜の形成方法及び該方法により得られた金皮膜付きフッ素系高分子材料 日本バルカー工業株式会社
- 15 非シアン無電解金めっき液及び無電解金めっき方法 新光電気工業株式会社
- 16 配線基板用フィルム基材、配線基板用フィルム基材の作製方法及びフレキシブルプリント基板 日立マクセル株式会社
- 17 めっき方法 住友金属鉱山株式会社
- 18 めっき皮膜評価方法 アルプス電気株式会社
- 19 化学的めっき方法 エヌイーシー ショット コンポーネンツ株式会社
- 20 無電解メッキ方法 三菱製紙株式会社
- 21 UV硬化性触媒組成物 ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.
- 22 銀被覆銅粉およびその製造方法並びに導電ペースト 同和鉱業株式会社
- 23 着色粒子の製造方法 エスケー化研株式会社
- 24 めっき液、めっき液の製造方法、表面処理方法及び接点部材 株式会社エルグ
- 25 機能性粒子及びその製造方法 日立マクセル株式会社
- 26 プリント配線板 イビデン株式会社
- 27 銀銅複合粉及び銀銅複合粉の製造方法 三井金属鉱業株式会社
- 28 ポリイミド樹脂の無機薄膜形成方法及び表面改質した無機薄膜形成用ポリイミド樹脂の製造方法 三ツ星ベルト株式会社
- 29 銅系素材用銀メッキ浴 石原薬品株式会社
- 30 DNAを用いた透明電極の作製方法 国立大学法人 北海道大学

以下36点省略

(セットB)

- 1 無電解パラジウムめっき液及びそれを用いて形成された3層めっき被膜端子 日本高純度化学株式会社
- 2 無電解めっき方法 アルプス電気株式会社
- 3 無電解硬質金めっき液 関東化学株式会社
- 4 基板の無電解めっき方法 アルプス電気株式会社
- 5 ワイヤーボンディング接合用の金めっき皮膜形成用無電解金めっき液 エヌ・イーケムキャット株式会社
- 6 電子部品及びその製造方法 新光電気工業株式会社
- 7 接続用端子、およびこれを有する半導体搭載用基板 日立化成工業株式会社
- 8 シアン化物非含有銀系メッキ浴、メッキ体及びメッキ方法 石原薬品株式会社
- 9 導電性回路の形成方法 三共化成株式会社
- 10 導電性組成物 信越化学工業株式会社
- 11 成形品の製造方法、押し出し成形装置及び成形品 日立マクセル株式会社
- 12 Cuコアボールとその製造方法 新日鉄マテリアルズ株式会社
- 13 回路パターン形成方法 株式会社大和化成研究所
- 14 金属被覆型有機結晶の製造方法 独立行政法人科学技術振興機構
- 15 置換銀メッキ浴 石原薬品株式会社
- 16 無電解パラジウムめっき浴及び無電解パラジウムめっき方法 上村工業株式会社
- 17 触媒処理方法、無電解めっき方法および無電解めっき方法を用いた回路形成方法 アルプス電気株式会社
- 18 溶解反応助剤を用いた金属溶解方法、この金属溶解方法を用いた合金の製造方法、並びに金属の析出方法 古屋伸 秀樹
- 19 無電解めっき方法及び白金めっき品並びに還元剤 田中貴金属工業株式会社
- 20 パターン形成方法及び液滴吐出ヘッド セイコーエプソン株式会社
- 21 金属担持多孔質シリコンの製造方法、燃料電池用電極構造体、及び燃料電池 学校法人東京理科大学
- 22 金属 - 多孔質基材複合材料及びその製造方法 財団法人電力中央研究所
- 23 非導電性基板表面のエッチング方法 エントーン インク.
- 24 プリント回路基板のメッキ層形成方法 およびこれから製造されたプリント回路基板 三星電機株式会社
- 25 無電解めっき用前処理方法及び無電解めっき皮膜の形成方法 奥野製薬工業株式会社
- 26 クロム酸 - 硫酸混液によるエッチング処理の後処理剤 奥野製薬工業株式会社
- 27 めっき装置 アルプス電気株式会社
- 28 無電解金めっき液及び無電解金めっき方法 日立化成工業株式会社
- 29 触媒処理方法および無電解めっき方法 アルプス電気株式会社
- 30 自己触媒型無電解金めっき液 奥野製薬工業株式会社

以下36点省略